

LC-2Q252

HDI・パッケージプリント配線板向け
高速高精度CO2レーザ加工機

非加工時間の低減により
トータル生産性がさらに向上
レーザ加工の世界標準マシン

NEW
新製品



安定性の追求と非加工時間の低減により生産性がさらに向上

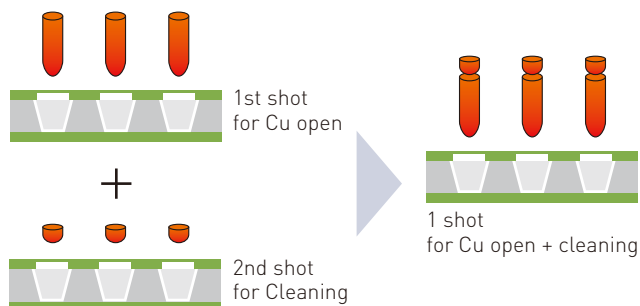
□パッケージ基板の加工技術で

HDI基板の小径・高精度ニーズに対応

小径化・高密度化での厳しい穴位置要求精度に応える、高剛性機械構造、各種補正システム。そして独自の各種熱対策が安定した加工精度を実現します。

□生産性の向上に貢献する新技術

独自の新レーザーパルス制御方式の採用により、ショット数が削減。生産性の向上と高品質加工の両立を実現しました。新型パワーセンサーの開発による測定時間の大幅短縮（当社比80%低減）、さらに新アプリケーションによって段取り時間を50%削減しました。非加工時間の低減がトータル生産性の向上に貢献します。



ショット数削減による加工速度の向上と
内層ダメージのない高品質加工の両立を実現

〈 特許
取得済み 〉

□業界トップクラスの加工速度

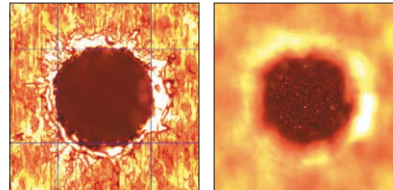
新設計の自社製高速ガルバノ搭載に加え、さらに進化した独自のXYテーブル、ガルバノ同期制御により、加工速度が飛躍的に向上しました（当社比125%以上）。

LC-2Q252／主仕様

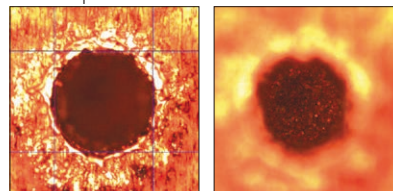
項目	内容
最大加工エリア	635×813mm 2パネル
XY早送り速度	50m/min
加工ヘッド数	2
レーザー出力	500W
スキャンエリア	□70mm (OP : □30mm, □50mm)
加工精度	±0.010mm
数値制御装置	MARK-55L

3Layer 加工

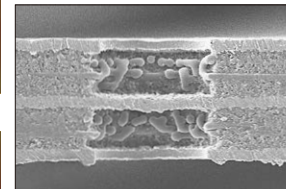
Front top view Front bottom view



Back top view Back bottom view

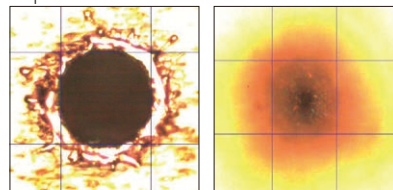


Cross section

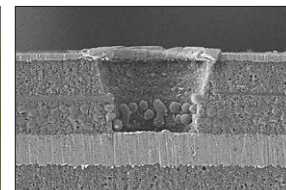


未処理Cuダイレクト加工 加工径 35μm

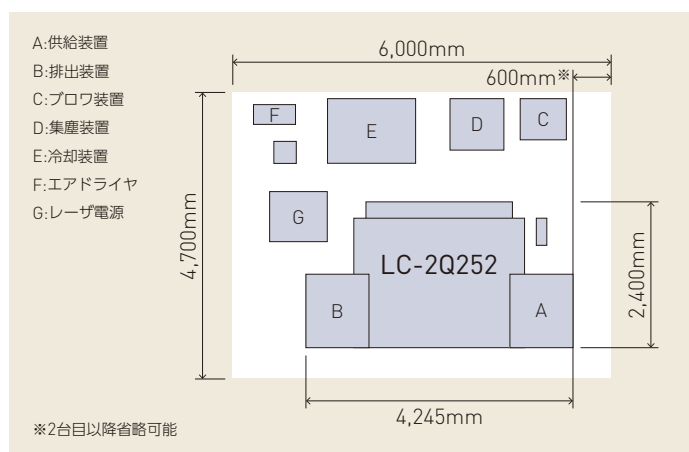
Top view Bottom view



Cross section



設置スペース



ビアメカニクス株式会社

本社／国内営業（東日本）：〒243-0488 神奈川県海老名市泉2-3-1
TEL. 046-235-9672 FAX. 046-235-9673
国内営業（西日本）：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-6-15
TEL. 052-262-0621 FAX. 052-262-0625
<http://www.viamechanics.com>

